

光学精密BGA返修设备返修台，多功能BGA返修台

产品名称	光学精密BGA返修设备返修台，多功能BGA返修台
公司名称	深圳市卓茂科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:卓茂 型号:ZM-7350 类型:光学返修台
公司地址	深圳市宝安区福永街道怀德翠海工业园10栋1、2层
联系电话	0755-29929955 13823357053

产品详情

zm-r6200返修台的主要特点：独立三温区控温系统 上下温区为热风加热，ir预热区为红外加热，温度精确控制在 ± 3 ，上下部发热器可从元器件顶部及pcb底部同时进行加热，并可同时设置多段温度控制；ir预热区可依实际要求调整加热面积，可使pcb板受热均匀。可对bga芯片和pcb板同时进行热风局部加热，同时再辅以大面积的红外发热器对pcb板底部进行预热，能完全避免在返修过程中pcb板的变形；通过选择可单独使用上部温区或下部温区，并自由组合上下发热体能量。选用高精度k型热电偶闭环控制和pid参数自整定系统；可同时显示四条温度曲线和存储多组用户数据，并具有瞬间曲线分析功能；外置测温接口实现对温度的精密检测，可随时对实际采集bga的温度曲线进行分析和校对。

精准的光学对位系统 本机的光学对位系统图像清晰，最大可放大至元器件的230倍，贴装精度可达 $\pm 0.01\text{mm}$ 。并且具有分光双色、放大、缩小和微调功能，配置15"高清液晶显示器。

多功能人性化的操作系统 采用高清触摸屏人机界面，该界面可设置“调试界面”和“操作界面”，以防作业中误设定；上部加热装置和贴装头一体化设计，能自动识别吸料和贴装高度，具有自动焊接和自动拆焊功能；同时温度可设置6段升温和6段恒温控制，并能储存n组温度设定参数，随时可根据不同bga进行调用。配备多种规格钛合金bga风嘴，该风嘴可 360° 任意旋转，易于安装和更换。pcb板定位采用v字型槽，定位快捷、方便、准确，满足不同pcb板排版方式及不同大小pcb板的定位；配灵活方便的可移动式万能夹具对pcb板起到保护作用，防止pcb边缘器件损伤及pcb变形，确保主板维修的成功率，并能适应各种bga封装尺寸的返修。优越的安全保护功能 本机经过ce认证，设有急停开关和异常事故自动断电保护装置；焊接或拆焊完毕后具有报警功能，在温度失控情况下，电路能自动断电，拥有双重超温保护功能。温度参数带密码保护，防止任意修改等多项安全保护及防呆功能，具有优越的安全保护功能，确保避免在任何异常状况下返修pcb及元器件损坏及机器自身损毁。

zm-r6200返修台的主要参数：电源: ac 220v $\pm 10\%$ 50/60 hz 总功率：max 5.2kw 加热器：上部温区 1200 w 下部温区 1200 w ir温区 2700 w 电气选材：智能可编程温度控制系统，支持电脑通讯。温度控制：k型热电偶闭环控制:上下独立测温, 温度精准范围 ± 3 定位方式：v型卡槽定位
pcb 尺寸: max 410 \times 370 mm 适用芯片: max 80 \times 80mm min 2 \times 2 mm
外形尺寸：1630 \times w370 \times h900 mm 测温接口：1个 机器重量：70kg 外观颜色：白色